

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年11月25日(2004.11.25)

【公開番号】特開2002-299481(P2002-299481A)

【公開日】平成14年10月11日(2002.10.11)

【出願番号】特願2001-106252(P2001-106252)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 23/02

【F I】

H 01 L 23/02

B

【手続補正書】

【提出日】平成15年12月3日(2003.12.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器であって、当該容器の開口枠の上端に蓋を密着して容器内を封止する構造の電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には金属層が形成されており、該金属層は上方に凸部を有するものあり、

前記開口枠の幅を0.4±0.1mmとし、

前記凸部の幅を0.15±0.05mmとし、

前記凸部の高さを5乃至20μmとしたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

【請求項2】

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器であって、当該容器の開口枠の上端に蓋を密着して容器内を封止する構造の電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には金属層が形成されており、該金属層は上方に凸部を有するものあり、

前記開口枠の幅を0.4±0.1mmとし、

前記凸部の幅を0.15±0.05mmとし、

前記凸部の高さを10乃至15μmとしたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

【請求項3】

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器と、当該容器の開口枠の上端に密着して容器内を封止する蓋とを備えた電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には金属層が形成されており、該金属層は上方に凸部を有するものあり、

前記開口枠の幅を0.4±0.1mmとし、

前記凸部の幅を0.15±0.05mmとし、

前記凸部の高さを5乃至20μmとしたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

【請求項4】

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器と、当該容器の開口枠の上端に密着して容器内を封止する蓋とを備えた電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には金属層が形成されており、該金属層は上方に凸部を有するものあり、

前記開口枠の幅を0.4±0.1mmとし、

前記凸部の幅を $0.15 \pm 0.05\text{ mm}$ とし、

前記凸部の高さを $10$ 乃至 $15\text{ }\mu\text{m}$ としたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

**【請求項 5】**

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器と、当該容器の開口枠の上端に密着して容器内を封止する蓋とを備えた電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には第1の金属層が設けられ、該第1の金属層上の幅方向中央には第2の金属層が設けられており、

前記開口枠の幅を $0.4 \pm 0.1\text{ mm}$ とし、

前記第2の金属層の幅を $0.15 \pm 0.05\text{ mm}$ とし、

前記第2の金属層の高さを $5$ 乃至 $20\text{ }\mu\text{m}$ としたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

**【請求項 6】**

電子部品を収容する上面が開口した箱形の容器と、当該容器の開口枠の上端に密着して容器内を封止する蓋とを備えた電子部品用パッケージに於いて、

前記開口枠の上端面には第1の金属層が設けられ、該第1の金属層上の幅方向中央には第2の金属層が設けられており、

前記開口枠の幅を $0.4 \pm 0.1\text{ mm}$ とし、

前記第2の金属層の幅を $0.15 \pm 0.05\text{ mm}$ とし、

前記第2の金属層の高さを $10$ 乃至 $15\text{ }\mu\text{m}$ としたことを特徴とする電子部品用パッケージ。

**【請求項 7】**

前記蓋は、少なくとも前記開口枠と接合される部分に金属面を有していることを特徴とする請求項3乃至6のいずれかに記載の電子部品用パッケージ。

**【請求項 8】**

前記容器の金属層と前記蓋の金属面との間をろう材にて接合することを特徴とする請求項7に記載の電子部品用パッケージ。

**【請求項 9】**

前記蓋の金属面にろう材をクラッド化しておき、前記容器の金属層と前記蓋の金属面との間を該ろう材にて接合したものであることを特徴とする請求項7又は8に記載の電子部品用パッケージ。

**【請求項 10】**

前記ろう材の厚みを約 $30\text{ }\mu\text{m}$ としたことを特徴とする請求項8又は9に記載の電子部品用パッケージ。

**【請求項 11】**

前記容器の金属層と前記蓋の金属面との間の接合をパルスヒート方式の加熱法にて接合したことを特徴とする請求項8乃至10のいずれかに記載の電子部品用パッケージ。